

通富微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	甬元私募：吴映江；飞天投资：杨秦南；银峰投资：杨轶捷、唐英培；永谐投资：朱晓宇、潘俊杰、史程；国海创新：王俊；大正投资：夏军；永卓控股：刘长丰；伟星资产管理：班梅；航天投资：张冕峰、汪音婕；湖北高投：陈豪、邝丽萍；志道投资：周林冲；国元基金：吴祥；东方嘉富：陈晓禾、莫辰宇；北京朗姿韩亚：田正大；四川璞信：陈燃；中信私募：谢娅舒、姜磊；青岛城投：郎需谦；江西江投：张笑航；上海毓盛：乔旭阳、林晓虹；苏银理财：马仁磊、窦杰；江苏银行：康玲伟、杨志勇；南通投资管理：施涛、万佳奇；江苏能达私募：洪伟、周泉；江苏金财投资：龚祖越；青岛城投：巫彬；国海证券：孟成桢；辉腾国际：杨娟
时间	2026年6月15日；
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 蒋澍
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、公司概况</p> <p>通富微电是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供从设计仿真到封装测试的一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位覆盖了人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等多个领域，满足了客户的多样化需求。公司大股东为南通华达微电子集团股份有限公司，实际控制人为石明达先生，股权结构稳定。</p> <p>公司先后在江苏南通崇川、南通苏通科技产业园、安徽合肥、福建厦门、南通市北高新区建厂布局；通过收购 AMD 苏州及 AMD</p>

槟城各 85%股权，在江苏苏州、马来西亚槟城拥有生产基地。2024 年，公司与相关方签订《股权买卖协议》，以自有资金收购京隆科技 26%股权，京隆科技运营模式和财务状况良好，其在高端集成电路专业测试领域具备差异化竞争优势。公司已于 2025 年 2 月 13 日完成交割并支付了相关股权购买价款，公司收购京隆科技部分股权可提高公司投资收益，为公司带来稳定的财务回报，为全体股东创造更多价值。

公司总部位于江苏南通，拥有全球化的制造和服务网络，在南通、合肥、厦门、苏州、马来西亚槟城布局九大生产基地，实现了高效率和高质量的生产能力，为全球客户提供快速和便捷的服务，在全球拥有超两万名员工。公司与客户紧密合作，致力于成为国际级集成电路封测企业，通过技术创新、市场拓展和产能提升等措施，不断提升公司的核心竞争力和市场地位。同时，公司也将积极响应国家产业政策导向，依托国家产业基金的支持，抓住集成电路产业快速发展的历史机遇，为推动我国集成电路产业的进步和发展做出贡献。

财务数据方面，公司 2023 年、2024 年、2025 年、2026 年第一季度分别实现营收 222.69 亿元、238.82 亿元、279.21 亿元和 74.82 亿元。公司 2023 年、2024 年、2025 年和 2026 年第一季度的归母净利润分别为 1.69 亿元、6.78 亿元、12.19 亿元和 3.29 亿元。

二、投资者关注的主要问题

问题 1：简单介绍一下公司的业务情况及应用领域？

回复：公司是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供从设计仿真到封装测试的一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位覆盖了人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等多个领域，满足了客户的多样化需求。公司紧紧抓住市场发展机遇，面向未来高附加值产品以及市场热点方向，立足长远，大力开发扇外型、圆片级、倒装焊等封装技术并扩充其产能；此外，积极布局 Chiplet、2D+等顶尖封装技术，形成了差异化竞争优势。

问题 2：请问本次向特定对象发行股票限售期是多久？

回复：本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月

内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次发行所取得的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

问题 3：本次发行的发行价格是多少？

回复：本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。

本次向特定对象发行股票的发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，上述均价的计算公式为：定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。

最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会根据股东会授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。

问题 4：请问本次向特定对象发行股票审核到什么程度了？

回复：公司本次向特定对象发行股票的申请已于 2026 年 6 月 3 日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施。最终能否获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。

问题 5：请简单分析一下本次募投项目“汽车等新兴应用领域封测产能提升项目”未来的发展趋势。

回复：在半导体应用领域中，车载领域对应的芯片类型多样，普遍面临工作环境复杂、生命周期长、对可靠性与功能安全标准极高等挑战，属于国产芯片渗透的难点领域。头部主机厂过往倾向选择验证体系成熟、量产经验丰富的海外厂商，导致车载芯片国产化起步相对较晚、推进节奏更为审慎。

当前，在新能源汽车、智能座舱与自动驾驶等新一代汽车电

	<p>子需求快速扩张的背景下，叠加国内半导体设计与制造能力持续提升，车载芯片国产替代逻辑正由“政策推动”逐步演变为“市场驱动”。一方面，终端厂商出于供应链安全、交付稳定性、成本管控以及本地协同效率等多重考虑，主动加大对国产车规芯片的验证与导入力度，从非核心的辅助类器件逐步延伸至车载MCU、SoC、BMS等环节；另一方面，国内厂商在产品可靠性设计、车规认证体系（如AEC-Q标准）、量产质量管控等方面加速追赶，可替代产品的性能指标与应用场景不断向中高端延伸，国产芯片与主机厂之间的协同开发也日趋常态化，形成了“本土需求—本土供给”相互强化的良性循环。</p> <p>面向车载等对芯片性能及可靠性要求较高的应用场景，芯片封测能力亦是确保产品性能稳定、信号完整与长期可靠的关键环节。本募投项目拟提升汽车等新兴应用领域封测产能，实现满足车规标准的封装产线扩产，加强高端测试能力的布局，积极响应国家政策及战略目标，为半导体国产化浪潮提供重要保障。</p> <p>问题 6：请简单分析一下本次募投项目“存储芯片封测产能提升项目”有关的下游发展机遇。</p> <p>回复：2024年以来，全球半导体市场整体景气度显著修复，AI、智能终端、新能源汽车等领域的持续扩张为存储市场带来增长动能，成为带动行业复苏的主要引擎。</p> <p>存储芯片作为数据密集型系统的核心支撑，其在服务器、PC、智能手机、汽车电子等多个场景中渗透率持续提升。在AI大模型推理及边缘侧智能化发展带动下，市场对高带宽、大容量、高可靠性的存储产品需求快速上行。同时，传统应用如个人电脑、手机等产品亦呈现出更新迭代快、结构性升级的趋势，推动存储市场在价格与比特总量两个维度同步增长。上述因素共同导致2025年以来存储市场供不应求的局面。在此背景下，国产厂商亦加速导入3D NAND、DDR5、LPDDR5等先进产品，形成放量趋势，对配套封装工艺能力、量产效率提出了更高要求。</p> <p>综上，本土封测企业正迎来覆盖存储芯片全产品线的新增需求窗口。本募投项目通过提升存储芯片的封测产能，有助于公司把握下游市场的快速发展机遇，提升营收规模及盈利水平。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2026年6月15日